



平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成30年11月8日

上場会社名 株式会社ダイヘン 上場取引所 東・福
 コード番号 6622 URL https://www.daihen.co.jp/
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 田尻 哲也
 問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 小澤 茂夫 (TEL) 06-6390-5506
 四半期報告書提出予定日 平成30年11月9日 配当支払開始予定日 平成30年12月4日
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成31年3月期第2四半期の連結業績 (平成30年4月1日～平成30年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
31年3月期第2四半期	68,545	1.7	3,393	△27.9	3,670	△26.6	2,583	△27.4
30年3月期第2四半期	67,378	14.8	4,705	82.6	4,998	104.2	3,556	141.6

(注) 包括利益 31年3月期第2四半期 1,283百万円(△68.7%) 30年3月期第2四半期 4,099百万円(-%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
31年3月期第2四半期	102.90	—
30年3月期第2四半期	141.64	—

※当社は、平成30年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益を算定しております。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
31年3月期第2四半期	161,875	82,425	47.6
30年3月期	167,803	82,107	45.7

(参考) 自己資本 31年3月期第2四半期 77,131百万円 30年3月期 76,715百万円

※「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、前連結会計年度に係る数値については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
30年3月期	—	7.50	—	7.50	15.00
31年3月期	—	8.00	—	—	—
31年3月期(予想)	—	—	—	40.00	—

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

※当社は、平成30年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。平成31年3月期(予想)の1株当たり期末配当金につきましては、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載し、年間配当金合計は「—」として記載しております。詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご参照ください。

3. 平成31年3月期の連結業績予想 (平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	144,000	△3.6	8,500	△15.5	8,800	△14.1	5,500	△19.5	219.07

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※平成31年3月期の通期の連結業績予想における1株当たり当期純利益につきましては、株式併合の影響を考慮しております。詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご参照ください。

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 一社(社名) 、除外 一社(社名)

(注) 連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動には該当いたしません。連結子会社でありました株式会社ダイヘンテクノスは、平成30年7月1日付で連結子会社であるダイヘン溶接メカトロシステム株式会社を存続会社とする吸収合併により消滅したため、当第2四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。なお、存続会社であるダイヘン溶接メカトロシステム株式会社は特定子会社であり、同日付で株式会社ダイヘンテクノサポートに商号変更しております。

- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(注) 詳細は、添付資料8ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 (四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご覧ください。

- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
② ①以外の会計方針の変更 : 無
③ 会計上の見積りの変更 : 無
④ 修正再表示 : 無

- (4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	31年3月期2Q	27,103,291株	30年3月期	27,103,291株
② 期末自己株式数	31年3月期2Q	1,997,762株	30年3月期	1,996,540株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	31年3月期2Q	25,106,192株	30年3月期2Q	25,112,248株

※ 当社は、平成30年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しております。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項については、添付資料2ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

(株式併合後の配当及び業績予想について)

当社は、平成30年6月27日開催の第154期定時株主総会において、株式併合について承認可決され、平成30年10月1日を効力発生日として、普通株式を5株につき1株の割合をもって株式併合を実施しております。併せて同日付で単元株式数の変更(1,000株から100株への変更)を実施しております。

なお、株式併合を考慮しない場合の平成31年3月期の配当予想及び連結業績予想は以下のとおりとなります。

- (1) 平成31年3月期の配当予想
1株当たり配当金 期末 8円00銭 年間配当金合計 16円00銭
- (2) 平成31年3月期の連結業績予想
1株当たり当期純利益 通期 43円81銭

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	8
(追加情報)	8
(セグメント情報等)	9
(企業結合等関係)	11
(重要な後発事象)	12

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期のダイヘングループを取り巻く経営環境は、後半にかけて半導体関連投資が調整局面となりましたが、生産自動化投資が好調を維持するなど、総じて堅調に推移いたしました。

その結果、売上高は685億4千5百万円（前年同期比1.7%増）となりましたが、利益面におきましては、耐震対策工事に伴う経費増加や素材価格上昇の影響により、営業利益は33億9千3百万円（前年同期比13億1千2百万円減）、経常利益は36億7千万円（前年同期比13億2千7百万円減）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益につきましても、25億8千3百万円（前年同期比9億7千3百万円減）となりました。

セグメント別の状況につきましては、以下のとおりであります。

① 電力機器事業

受変電システム事業強化の取組み成果により、受注高は339億9千4百万円（前年同期比6.2%増）となりましたが、太陽光発電関連機器の需要減少により、売上高は279億5千9百万円（前年同期比4.5%減）となりました。また、国内生産拠点での工場建替えに伴う減価償却費増加や銅価格上昇等の影響により、営業利益は7億3千万円（前年同期比11億4千1百万円減）となりました。

② 溶接メカトロ事業

米中貿易摩擦の影響により中国での設備投資は先送り傾向となりましたが、東南アジア、欧州を中心に自動車関連投資が堅調に推移いたしました結果、受注高は222億3千万円（前年同期比2.7%増）、売上高は217億1千6百万円（前年同期比4.0%増）、営業利益は18億3千2百万円（前年同期比3千3百万円増）となりました。

③ 半導体関連機器事業

3次元メモリーやDRAM向けの設備投資が堅調に推移いたしました結果、売上高は187億8千8百万円（前年同期比9.6%増）となりましたが、半導体関連投資は調整局面にあり、受注高は137億7千7百万円（前年同期28.0%減）となりました。これまでに実施した増産対応投資に伴うコスト増加もあり、営業利益は27億7千1百万円（前年同期比1億1千2百万円減）となりました。

④ その他

売上高は9千9百万円、営業利益は4千万円で、前年同期からの大きな変動はありません。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期末の資産合計は、主に受取手形及び売掛金の減少により1,618億7千5百万円（前年度末比59億2千7百万円減）となりました。

負債合計は支払手形及び買掛金や借入金などの減少により794億5千万円（前年度末比62億4千5百万円減）となりました。

純資産合計は、為替換算調整勘定やその他有価証券評価差額金が減少する一方、利益剰余金の増加により824億2千5百万円（前年度末比3億1千7百万円増）となりました。なお、自己資本比率は前年度末の45.7%から1.9ポイント上昇して47.6%となりました。

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連結会計年度末との比較・分析を行っております。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の業績予想につきましては、前回公表値（平成30年10月22日公表）を修正しておりません。今後、業績予想の修正が必要となった場合には、速やかに公表させていただきます。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	14,430	10,392
受取手形及び売掛金	39,658	30,082
商品及び製品	14,394	17,632
仕掛品	10,462	11,609
原材料及び貯蔵品	15,673	18,640
その他	4,949	4,022
貸倒引当金	△45	△19
流動資産合計	99,524	92,360
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	18,483	19,612
機械装置及び運搬具（純額）	7,534	7,290
工具、器具及び備品（純額）	1,923	1,920
土地	9,327	9,310
リース資産（純額）	580	547
建設仮勘定	2,307	3,008
有形固定資産合計	40,158	41,688
無形固定資産		
のれん	1	—
ソフトウェア	1,831	1,821
リース資産	39	33
その他	303	289
無形固定資産合計	2,177	2,144
投資その他の資産		
投資有価証券	17,772	17,208
出資金	192	192
長期貸付金	2	1
長期前払費用	228	218
退職給付に係る資産	6,340	6,519
繰延税金資産	950	1,099
その他	545	554
貸倒引当金	△89	△112
投資その他の資産合計	25,943	25,683
固定資産合計	68,278	69,515
資産合計	167,803	161,875

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	34,645	31,743
短期借入金	12,085	8,027
1年内返済予定の長期借入金	4,288	5,438
リース債務	189	179
未払法人税等	1,753	1,254
賞与引当金	3,303	2,494
役員賞与引当金	111	20
工事損失引当金	68	57
その他	6,878	6,167
流動負債合計	63,322	55,381
固定負債		
長期借入金	16,071	18,002
リース債務	405	362
繰延税金負債	2,070	1,911
役員退職慰労引当金	34	31
耐震工事関連費用引当金	841	798
製品安全対策引当金	40	33
退職給付に係る負債	1,725	1,744
資産除去債務	75	74
その他	1,109	1,110
固定負債合計	22,373	24,068
負債合計	85,695	79,450
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,596	10,596
資本剰余金	10,009	10,009
利益剰余金	50,848	52,487
自己株式	△3,074	△3,079
株主資本合計	68,379	70,014
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	5,201	4,899
繰延ヘッジ損益	△3	0
為替換算調整勘定	2,707	1,817
退職給付に係る調整累計額	431	400
その他の包括利益累計額合計	8,335	7,117
非支配株主持分	5,392	5,293
純資産合計	82,107	82,425
負債純資産合計	167,803	161,875

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
売上高	67,378	68,545
売上原価	45,128	47,389
売上総利益	22,250	21,155
販売費及び一般管理費	17,544	17,762
営業利益	4,705	3,393
営業外収益		
受取利息及び配当金	173	187
持分法による投資利益	76	12
為替差益	62	22
その他	269	424
営業外収益合計	583	647
営業外費用		
支払利息	112	92
売上割引	78	84
その他	99	194
営業外費用合計	290	370
経常利益	4,998	3,670
税金等調整前四半期純利益	4,998	3,670
法人税等	1,356	1,170
四半期純利益	3,642	2,500
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	85	△82
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,556	2,583

四半期連結包括利益計算書

第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
四半期純利益	3,642	2,500
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	921	△315
繰延ヘッジ損益	△5	4
為替換算調整勘定	△449	△891
退職給付に係る調整額	△49	△35
持分法適用会社に対する持分相当額	40	21
その他の包括利益合計	457	△1,217
四半期包括利益	4,099	1,283
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	4,011	1,364
非支配株主に係る四半期包括利益	88	△81

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	4,998	3,670
減価償却費	2,249	2,617
のれん償却額	2	1
貸倒引当金の増減額(△は減少)	13	△2
賞与引当金の増減額(△は減少)	△647	△804
耐震工事関連費用引当金の増減額(△は減少)	△37	△42
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	55	16
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	△25	△258
受取利息及び受取配当金	△173	△187
支払利息	112	92
持分法による投資損益(△は益)	△76	△12
売上債権の増減額(△は増加)	4,430	9,251
たな卸資産の増減額(△は増加)	△5,116	△7,789
仕入債務の増減額(△は減少)	△155	△2,087
その他	△1,227	147
小計	4,399	4,613
利息及び配当金の受取額	174	189
利息の支払額	△119	△91
法人税等の支払額	△1,293	△1,641
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,160	3,069
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△98	—
定期預金の払戻による収入	32	296
有形固定資産の取得による支出	△5,170	△4,700
有形固定資産の売却による収入	4	28
無形固定資産の取得による支出	△340	△272
子会社株式の取得による支出	△71	△0
短期貸付金の純増減額(△は増加)	1,426	—
その他	△26	200
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,244	△4,448
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	△954	△4,014
長期借入れによる収入	2,500	5,000
長期借入金の返済による支出	△928	△1,919
自己株式の取得による支出	△19	△4
配当金の支払額	△755	△942
その他	△244	△116
財務活動によるキャッシュ・フロー	△403	△1,997
現金及び現金同等物に係る換算差額	△101	△313
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△1,589	△3,689
現金及び現金同等物の期首残高	13,803	13,671
現金及び現金同等物の四半期末残高	12,214	9,981

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

・税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、税引前四半期純利益に一時差異等に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。

(追加情報)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

(セグメント情報等)

I 前第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				その他 (注)	合計
	電力機器 事業	溶接メカトロ 事業	半導体関連 機器事業	計		
売上高						
外部顧客への売上高	29,289	20,848	17,142	67,280	98	67,378
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	29	—	29	—	29
計	29,289	20,877	17,142	67,310	98	67,408
セグメント利益	1,871	1,799	2,884	6,555	40	6,595

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等を含んでおりません。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

利益	金額
報告セグメント計	6,555
「その他」の区分の利益	40
セグメント間取引消去	0
全社費用(注)	△1,890
四半期連結損益計算書の営業利益	4,705

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント				その他 (注)	合計
	電力機器 事業	溶接メカトロ 事業	半導体関連 機器事業	計		
売上高						
外部顧客への売上高	27,957	21,698	18,788	68,445	99	68,545
セグメント間の内部売上高 又は振替高	1	17	—	19	—	19
計	27,959	21,716	18,788	68,465	99	68,565
セグメント利益	730	1,832	2,771	5,334	40	5,374

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等を含んでおりません。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位：百万円)

利益	金額
報告セグメント計	5,334
「その他」の区分の利益	40
セグメント間取引消去	0
全社費用(注)	△1,981
四半期連結損益計算書の営業利益	3,393

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(企業結合等関係)

共通支配下の取引等

連結子会社間の吸収合併

(1) 取引の概要

① 結合当事企業の名称及びその事業の内容

結合企業の名称 ダイヘン溶接メカトロシステム株式会社

事業の内容 溶接機、切断機、産業用ロボット等の販売

被結合企業の名称 株式会社ダイヘンテクノス

事業の内容 溶接機、切断機、産業用ロボット、クリーン搬送ロボット、分散電源機器等に関連する保守・点検

② 企業結合日

平成30年7月1日

③ 企業結合の法的形式

ダイヘン溶接メカトロシステム株式会社（当社の連結子会社）を存続会社、株式会社ダイヘンテクノス（当社の連結子会社）を消滅会社とする吸収合併

④ 結合後企業の名称

株式会社ダイヘンテクノサポート（当社の連結子会社）

⑤ その他取引の概要に関する事項

中期経営計画の方針であるセールスエンジニアリング力の強化に向けて、営業マンを現場での修理や溶接ノウハウの指導力を合わせ持つセールスエンジニアに育成し、営業・サービス一体化により顧客サポート力の向上を図ることを今回の合併の目的としております。

(2) 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引として処理しております。

(重要な後発事象)

株式併合及び単元株式数の変更

当社は、平成30年5月10日開催の取締役会において、会社法第195条第1項の規定に基づき、単元株式数の変更及び定款の一部変更について決議するとともに、平成30年6月27日開催の第154期定時株主総会に株式併合に関する議案を付議することを決議し、同株主総会において承認可決され、平成30年10月1日付でその効力が発生しております。

1 株式併合及び単元株式数の変更の目的

全国証券取引所は「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、上場する国内会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しております。

当社は、東京証券取引所及び福岡証券取引所に上場する企業としてこの趣旨を踏まえ、当社株式の売買単位である単元株式数を1,000株から100株に変更するとともに、証券取引所が望ましいとする投資単位の水準（5万円以上50万円未満）に調整することを目的として、株式併合を実施しております。

2 株式併合の内容

(1) 株式併合する株式の種類

普通株式

(2) 株式併合の方法・割合

平成30年10月1日付をもって、平成30年9月30日（実質上9月28日）の最終の株主名簿に記録された株主の所有株式数を5株につき1株の割合で併合いたしました。

(3) 株式併合により減少する株式数

株式併合前の発行済株式総数（平成30年9月30日現在）	135,516,455株
株式併合により減少する株式数	108,413,164株
株式併合後の発行済株式総数	27,103,291株

(4) 1株未満の端数が生じる場合の処理

株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主に対して、端数の割合に応じて配分いたします。

(5) 効力発生日における発行可能株式総数

108,000,000株

株式併合の割合にあわせて、従来の540,000,000株から108,000,000株に減少いたしました。

3 単元株式数の変更の内容

株式併合の効力発生と同時に、当社普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたしました。

4 株式併合及び単元株式数の変更の日程

取締役会決議日	平成30年5月10日
株主総会決議日	平成30年6月27日
株式併合及び単元株式数の変更の効力発生日	平成30年10月1日

5 1株当たり情報に及ぼす影響

当該株式併合が与える影響は、（サマリー情報）に反映されております。

自己株式の取得

当社は、平成30年10月22日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、以下のとおり、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。

1 自己株式の取得を行う理由

1 株当たりの株主価値および資本効率の向上を図るため。

2 取得に係る事項の内容

- | | |
|----------------|-----------------------------------------------|
| (1) 取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得し得る株式の総数 | 300,000株（上限）
（発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 1.2%） |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 900百万円（上限） |
| (4) 取得期間 | 平成30年10月23日から平成30年12月28日まで |
| (5) 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |

(注) 「取得し得る株式の総数」については、平成30年10月1日付の株式併合後の株式数で記載しております。